

New Release

LTEC Corporation

Your most experienced partner in IP protection

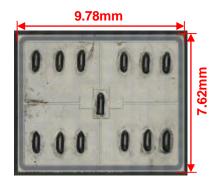
Infineon製 EasyPACK IGBTモジュール「FS100R12W2T7_B11」 (TRENCHSTOP IGBT7) 構造解析、プロセス解析オープンレポート

株式会社エルテックは、Infineon IGBT モジュール「FS100R12W2T7_B11」に搭載されている第7世代IGBT(IGBT7) の構造解析、プロセス・デバイス解析レポートをリリースしました。

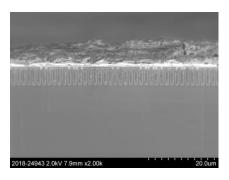




モジュール写真



チップ写真



セル部断面SEM写真

製品の特徴

「FS100R12W2T7_B11」は、Infineon最新の第7世代IGBTを搭載 Vces=1200V、Ic=100A。 アプリケーションとしては、産業用ドライブ向けの製品になります。

IGBT7は、飽和電圧Vce、satを低減するための新しい高密度Micro Pattern Trench(MPT)構造/レイアウトセルアレイを特徴としています。

前世代のIGBT6と比較するとIGBT7は、Vce(sat)が1.85Vから1.5Vに約19%程度改善されています。

解析のポイント

- ・単位IGBTセルは7つのトレンチのグループによって形成され、これらのトレンチの接続について明らかにしています。
- ・製造プロセス技術について、最小加工寸法であるコンタクト開口部から有効なプロセス技術ノードを 抽出しています。
- ・IGBT7とIGBT6トランジスタのオフ時コレクタリーク電流を比較。活性化エネルギーの有意差が確認されます。
- ・IGBTチップと並列接続されたFWDのブレ―ダウン電圧をそれぞれ測定しています。



1. IGBTモジュール、IGBT7構造解析レポート

| 【目次】 | | | 頁 |
|------|-----|-----------------------|---------|
| 1 | | 表1: デバイスサマリー | 3 |
| | 1-1 | 解析結果まとめ | 4-8 |
| | | 表2:デバイス構造: Si IGBT | 9 |
| | | 表3: デバイス構造: レイヤー材料・膜厚 | 10 |
| | | 表 4: 実装パッケージ構造概要 | 11 |
| 2 | | モジュール解析 | 12 |
| | 2-1 | 外観観察 | 13-16 |
| | 2-2 | チップ写真 | 17-18 |
| | 2-3 | モジュール断面観察 | 19-44 |
| 3 | | Si IGBTチップ解析 | 45 |
| | 3-1 | 平面構造解析(OM) | 46-73 |
| | 3-2 | 平面構造解析(SEM) | 74-86 |
| | 3-3 | 断面構造解析(SEM) | 87-103 |
| 4 | | 電気特性評価 | 104 |
| | 4-1 | 測定箇所 | 105 |
| | 4-2 | Ic-Vce特性 | 106-107 |
| | 4-3 | オフ状態のコレクタ電流の比較 | 108 |
| | 4-4 | オフ状態のコレクタ耐圧電圧 | 109 |
| 5 | | 付録 EDX分析結果 | 110-135 |
| 6 | | 付録 追加解析リスト | 136-137 |



2. IGBT7プロセス、デバイス特性解析レポート

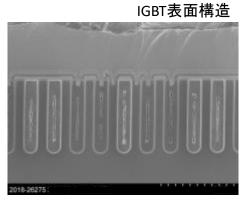
| 【目 | 次】 | | 頁 |
|----|-----|--|-------|
| 1 | | Infineon第7世代IGBT7(FS100R120C2T7) | |
| | | ェグゼクティブサマリー `・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
| | 1-1 | IGBT5, IGBT6とIGBT7の特性比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4-5 |
| | 1-2 | モジュール構造とチップ実装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| | 1-3 | Si IGBTチップ全体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
| | 1-4 | MPT IGBTセル模式図とその等価回路要素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
| | 1-5 | 平面構造解析(SEM) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9 |
| | 1-6 | MPT IGBTユニットセル構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
| | 1-7 | IGBTセルの進化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 2 | | Infineon第7世代IGBT7(FS100R120C2T7)解析結果まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12-13 |
| 3 | 3-1 | デバイス構造:チップ端部(平面構造解析)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| | 3-2 | デバイス構造:チップ端部(断面構造解析)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15-16 |
| | 3-3 | デバイス構造:チップ端部(Channel Stopper) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17-19 |
| | 3-4 | デバイス構造:IGBTアレー(断面構造解析)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20-22 |
| 4 | | 製造プロセスフロー解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
| | 4.1 | Si-IGBTのフロントエンドウェーハプロセスフロー(推定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| | 4.2 | アライメントツリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
| | 4.3 | INFINEON IGBT7のプロセス・シーケンス断面図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26-31 |
| | 4.4 | IGBT構成とレイアウト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32-34 |
| 5 | | 電気特性評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 35 |
| | 5-1 | 電気特性評価: 測定箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
| | 5-2 | 電気的特性: Ic-Vce特性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 37-38 |
| | 5-3 | 電気的特性:オフ状態のコレクタ電流特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39-41 |
| | 5-4 | 電気的特性:IGBT-7のオフ状態のコレクタ電流と活性化エネルギーEa ・・・・・・・ | 42 |
| | 5-5 | 電気的特性:オフ状態のコレクタ耐圧電圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
| | 5-6 | 電気的特性: IGBT7とIGBT6のオフリーク電流の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
| 6 | | 関連文献目録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 45 |
| 7 | | 関連特許目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46-51 |



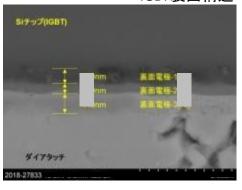
●構造解析レポートからの抜粋

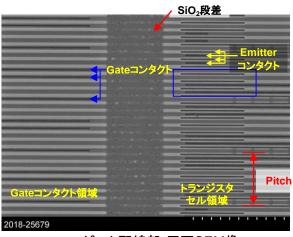


上部配線 絶縁層
下部配線



IGBT裏面構造

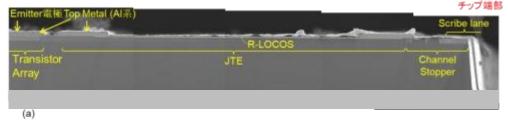


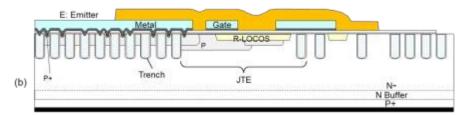


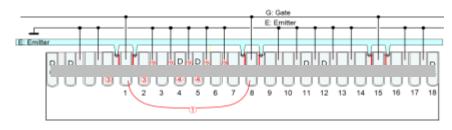
ゲート配線部 平面SEM像



●プロセス、デバイス特性解析レポートからの抜粋 (1)







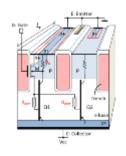
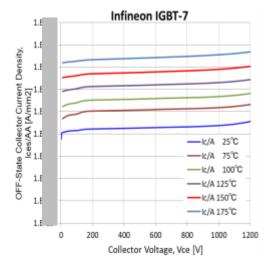
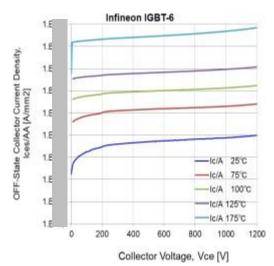


Fig.1-6-1 IGBT7 MPTセルアレイ構成





IGBT7とIGBT6の単位面積当たりのオフ状態のコレクタリーク電流の比較

●プロセス、デバイス特性解析レポートからの抜粋 (2)

製造プロセスフロ一解析



INFINEON IGBT7のプロセス・ シーケンス断面図

